



# 8440 HS

## 製品案内

HAF熱活性接着フィルム  
ICスマートカードにチップモジュールの装着用

## 製品の説明

tesa HAF 8440 は熱可塑性コポリアミドを主成分にした熱活性両面接着フィルムです。

製品特性：

- 優れた耐老化性\* カードに実装しても透明ですので目立ちません

## 特徴

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Good ageing resistance
- Invisible on assembled card

## 用途

- PVC、ABS、PET、PC 等の各種カード材質に適用。
- 全てのICカード装着ラインに適合。
- ICスマートカードのチップモジュールの装着、様々な用途に装着可能。

## 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

## 製品の構成

- |       |        |        |       |
|-------|--------|--------|-------|
| • 基材  | 無し     | • ライナー | グラシン  |
| • 粘着剤 | コポリアミド | • 総厚   | 40 µm |

## 特性 / 性能

- 接着強度 12 N/mm<sup>2</sup>

## 備考

Technical Recommendations:

The following values are recommendation for machine parameters to start with. Please note that optimum parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies and chip-modules as well as customer requirements.

1. Pre-lamination:

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=08440>



# 8440 HS

## 製品案内

### 備考

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. This step can be performed inline or offline. The pre-lamination step does not effect the shelf life time of the adhesive tape.

Machine setting:

- Temperature 130 - 140 °C
- Pressure 2 - 3 bar
- Time 2.5 m/min

2. Module Embedding:

During module embedding, the pre-laminated modules are die cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. For this step, the exact handling depends on the type of the implanting line used. Single step and multiple step can be used. Today, multiple step is common:

Single step process - Machine setting :

- Temperature<sup>1</sup> 180 – 220 °C
- Pressure 65 - 75 N/module
- Time 1.5 s

Multiple step process (2 or more heating stamps) - Machine setting:

- Temperature<sup>1</sup> 180 – 220 °C
- Pressure 65 - 75 N/module
- Time 2 x 0,7 s. /3 x 0.5 s

<sup>1</sup> Temperature as measured inside the heating stamp. Different temperature settings are recommended for different card material:

- \*PVC 180 - 190 °C
- \*ABS 180 - 190 °C
- \*PC 200 - 220°C

For applicants other than chip module implanting, different machine parameters should be used.

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. Value is guaranteed clearance limit checked with each production batch (Material: Etched aluminium test specimen / Bonding conditions: Temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min)

Storage conditions according to tesa HAF® shelf life concept.



# 8440 HS

製品案内

## 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=08440>